



VIA Technologies, Inc.

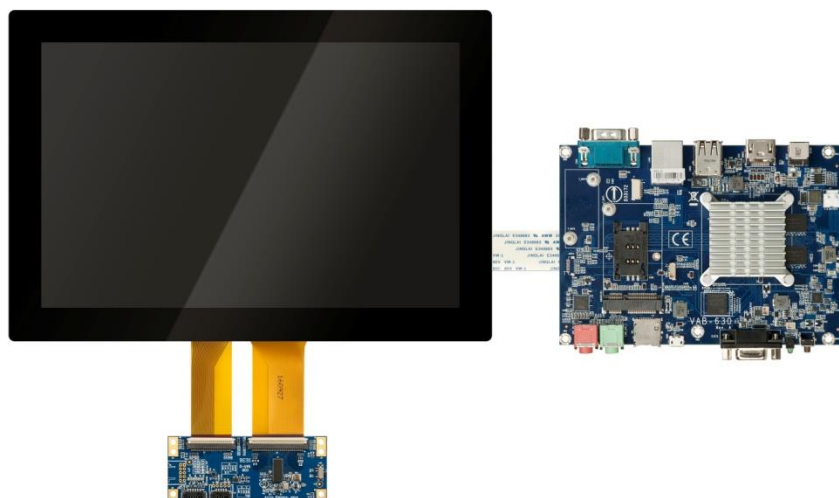
531 Zhongzheng Road, 1F | Xindian Dist, New Taipei City 231 | Taiwan
Tel: +886-2-2218-1838 | Fax: +886-2-2218-8924 | www.viatech.com

即時発表用

VIA、スマートサイネージのイノベーションを加速する VAB-630 プラットフォームを発表 豊富なマルチメディア・タッチスクリーン・アプリケーションと ディスプレイ・アプリケーションのための、超小型かつ拡張性の高いソリューション

2017年1月25日 台湾・新北市 – VIA Technologies, Inc.は本日、小売、オフィス、工場におけるスマートサインの導入を加速する、新しいVIA VAB-630 HMI(マン・マシン・インターフェース)システムプラットフォームを発表しました。

高度に統合された 3.5 〃SBC フォームファクターマザーボードとオプションの 10.1 インチタッチパネルスクリーンを組み合わせた VIA VAB-630 は、高度な計算、グラフィックス、ビデオ機能を搭載しており、キオスク、サイネージディスプレイおよびファクトリオートメーション HMI システムが含まれます。USB Wi-Fi と Bluetooth モジュールまたは miniPCIe 3G モジュールの組み合わせなど、オプションの無線通信モジュールを統合することで、機能をさらに強化することができます。



VIA Technologies, Inc.国際マーケティング担当 VP のリチャード・ブラウンは「VIA VAB-630 は、スマートサインと HMI システムを構築するためのコンパクトでスケーラビリティの高いプラットフォームを提供します。また、柔軟性の高い設計により、スマートな小売サイネージシステムでもマルチメディア情報キオスクでも、正確な使用要件を満たすことができます」とコメントしています。

VIA、スマートサイネージのイノベーションを加速する VAB-630 プラットフォームを発表

2/3

VIA VAB-630 プラットフォームを含む最新の VIA スマートサインと HMI ソリューションは、今年 3 月 14 日～16 日にドイツ・ニュルンベルクで開催される Embedded World 2017 に出品予定です。同展示会に参加予定の方は、ぜひ、Hall 2 のブース #2-551 の VIA ブースにお立ち寄りください。

VIA VAB-630

VIA VAB-630 は、高度なマルチメディアパフォーマンス、豊富な I/O および無線接続サポート、多数のゲートウェイ、サイネージ、HMI アプリケーション用の高度なソフトウェア開発ツールを提供します。主な機能は次のとおりです。

- ・ わずか 14.6cm×10.2cm の超小型 3.5 "SBC フォームファクタ
- ・ 1.0GHz デュアルコア VIA Cortex-A9 SoC
- ・ スムーズな 1080p ビデオ再生をサポート
- ・ HDMI、ミニ PCIe、USB 2.0、UART、SIM カードスロット、および DIO を含む豊富な I/O サポート
- ・ 3G、Wi-Fi、および Bluetooth 無線接続のサポート
- ・ オプションの 5V または 12V 電源入力
- ・ ウォッチドッグタイマ(WDT)、GPIO と UART アクセス、サンプルアプリなど、多数の API で構成される VIA Smart ETK を搭載した Android 5.0 BSP。
- ・ オプションの 10.1 インチ LVDS LCD タッチパネル

なお、市場投入までの時間を短縮し、開発コストを最小限に抑えるハードウェアおよびソフトウェアカスタマイズサービスのフルセットもご利用いただけます。

VIA VAB-630 の詳細については、次の URL をご参照ください。

<http://www.viatech.com/ja/boards-ja/3-5-inch-sbc/vab-630/>

本リリースに関連する画像については、<http://www.viagallery.com/vab-630/> をご覧ください。

Embedded World 2017 における VIA の出展内容などの情報は、

<http://www.viatech.com/ja/embedded-world-2017-ja> をご参照ください

VIA Technologies, Inc.について

VIA Technologies, Inc.は、高度に統合された組み込み用プラットフォームと、ビデオウォールやデジタル看板からヘルスケアや企業オートメーションまでにわたる M2M、IoT、そしてスマートシティアプリケーションの開発において国際的に主導的な役割を果たしています。本社を台湾・台北におき、VIA の国際的なネットワークはアメリカ、ヨーロッパ、そしてアジアのハイテクセンターを結び、顧客層は世界中の最先端のハイテク、通信、家電にまでわたっています。詳しくはこちらをご覧ください。

<http://www.viatech.com/>

VIA、スマートサイネージのイノベーションを加速する VAB-630 プラットフォームを発表 3/3

お客様からのお問い合わせ先

VIA Technologies Japan 株式会社

メールアドレス: mktjp@viatech.co.jp

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ

Richard Brown (VIA Technologies, Inc. 国際マーケティング担当 VP)

メールアドレス : RIBrown@via.com.tw

HaNaRe PR Group (VIA Technologies, Inc. 日本広報代理)

メールアドレス : press@hanare-pr.jp

記者ならびに編集の方々へお願い: VIA はすべて大文字で表記してください。